

证券简称：寒武纪

证券代码：688256

中科寒武纪科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	（排名不分先后，按字母顺序排列）安信基金、安信证券、百年人寿、宝盈基金、毕盛投资、博时基金、长江养老、长江资管、诚业投资、创金合信基金、大成基金、丰熙投资、高毅资管、广发基金、国寿安保基金、国泰基金、横琴人寿、华安资产、华商基金、汇丰晋信、弘毅远方、嘉实基金、建信基金、金恩投资、金元顺安、金鹰基金、宽远资产、利剑投资、民生加银、明河投资、摩根华鑫基金、诺安基金、平安基金、平安养老、平安资管、浦银安盛、申菱基金、申万宏源自营、趣时资产、晟盟资管、泰康基金、太保资产、太平资产、泰信基金、信诚基金、新华基金、兴全基金、益民基金、易同投资、银河基金、银华基金、源乘投资、止于至善投资、中海基金、中华联合保险、中泰自营、中银基金。
时间	2021 年 5 月 11 日
形式	☒ 现场 ☐ 网络会议 ☒ 电话会议
地点	北京
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：陈天石 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：叶淦尹 证券事务代表：童剑锋

投资者关系活动 主要内容介绍	一、英伟达每年持续大量的研发投入，通过 GPU 占据主要的市场份额。与之相比，公司的竞争优势是什么？ 答：与友商相比，公司的竞争优势体现在以下两个方面： 一是公司的芯片架构针对人工智能应用及各类算法进行了优化，有效提升了产品的性能功耗比和性能价格比。而友商在研发人工智能芯片时，更多基于其原有的技术储备和设计理念去适配人工智能的应用和算法，但 GPU 本身并非专门为人工智能相关运算进行开发的芯片产品。在相同芯片面积下，公司的芯片在处理人工智能任务时，效率可能更高且能发挥芯片的最佳性能。 二是公司和国内客户的物理距离更近，可以更快速地了解国内客户的需求，并且为客户提供快速响应、灵活的技术支持服务，充分发挥芯片产品的性能。而境外芯片公司主要研发人员位于境外，对于国内客户的系统软件定制优化需求响应较慢，可能影响芯片产品发挥最佳性能。 二、开始从事人工智能芯片设计的互联网公司，是否会与公司形成业务竞争关系？ 答：互联网巨头研发人工智能芯片主要是围绕其主营业务或针对特定应用场景完成完整或较为完整的行业解决方案，在其他人工智能应用场景仍存在巨大的市场需求。而公司已经成为一家具备软硬件全栈系统能力的芯片设计公司，可以为互联网公司提供不同尺寸、全品类多场景的产品及统一的平台化基础系统软件，满足客户的差异化需求。 三、公司如何确保通用智能芯片的迭代方向正确且能顺应市场需求？ 答：公司定位于独立的芯片设计公司，虽然不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售，但对各类人工智能算法和应用
---------------------------	---

	场景有着深入的研究和理解,而且基于核心团队多年的科研经历,对芯片前沿技术保持较高的敏锐度,能紧跟智能算法未来发展趋势,及时调整架构、扩充指令集。同时,面向新兴应用场景和客户需求,公司能研发和销售性能优越、能效出色、易于使用的智能芯片及配套系统软件产品,支撑客户便捷地开展智能算法基础研究、开发各类人工智能应用产品。 四、公司如何看待 2020 年终端智能处理器 IP 授权业务的收入情况以及对该业务未来的展望? 答:公司致力于提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。终端智能处理器 IP 授权业务在公司成立初期作为技术输出,帮助公司快速实现产品化,为公司发展赢得了一定的先发优势;随着云边端产品线的丰富,终端智能处理器 IP 授权将逐渐成为公司业务发展的一个中间形态,收入贡献不及实体芯片和板卡,但仍是公司业务的重要组成部分,有助于打造、推广公司云边端统一的人工智能开发生态。具体而言,终端 SoC 芯片公司可通过集成公司的处理器 IP 产品快速获得人工智能处理能力,通过使用寒武纪提供的云边端一体化的人工智能基础软件平台进行开发,上述 SoC 芯片公司及其客户将成为寒武纪生态的组成部分,生态的推广也将推动公司云端或边缘端芯片产品的广泛使用。 五、公司未来的销售策略或规划是什么? 答:对于芯片公司,抢占市场、占据市场优势地位是至关重要的。短期来看,公司的主要目标是抓住战略机遇期,深耕行业客户,以目标客户需求为导向,将客户的开发需求有效融入公司的产品定义乃至技术创新,有针对性地推广和销售公司产品,为客户提供优质的技术支持服务。未来,随着对客户支持的优化和完善,公司新产品从导入到完成适配的周期将缩短。
--	--

	同时，若能与行业头部客户保持良好合作，则能在市场上形成标杆或示范作用，以点带面推动公司产品在更多标志性应用场景落地，实现公司产品在市场渗透率上的重大提升。 六、公司研发投入使用在哪些方面？未来是否会持续进行研发投入？ 答：公司研发费用主要由职工薪酬、固定资产及无形资产的折旧及摊销、测试化验加工费等构成，具体投向芯片产品的迭代研发以及基础系统软件（可用于云边端各产品线）的持续优化方面。 目前，人工智能芯片已受到多家集成电路龙头企业的重视，也成为多家初创集成电路设计公司的发力重点。随着越来越多的厂商推出人工智能芯片产品，该领域市场竞争日趋激烈。总体来看，人工智能芯片技术仍处于发展的初期阶段，技术迭代速度加快，技术发展路径尚在探索中，尚未形成具有绝对优势的技术路线。 公司矢志成为国际领先的人工智能芯片设计公司。复杂的智能芯片设计需要持续的研发投入，用于有技术含量的自主创新、新产品研发、芯片设计与软件系统工程等方面的人才引进以及保持核心团队稳定，以保持公司技术的前瞻性、领先性和核心竞争优势。 七、公司如何看待智能驾驶、车载智能驾驶芯片？公司是否考虑切入到此领域发展？ 答：智能驾驶是人工智能芯片行业的重要应用领域，智能驾驶系统的核心是芯片。一方面，汽车的操作和人机交互界面将越来越智能化，未来汽车的中控系统会有大量的智能计算能力需求；另一方面，随着智能算法的成熟，自动驾驶将成为可能，自动驾驶会消耗大量的计算资源，因此对于车载智能芯片的需求也会迅速扩大。汽车的新能源化和网联化进程必将要求底层
--	--

	硬件能够支撑高速运算的同时保持低功耗，未来智能芯片在车载领域具备广阔的市场空间。 智能驾驶是一个复杂的体系，并非一颗车载智能驾驶芯片就能撑起来，更在于“云边端车”四位一体的联动效应。具体而言，车载智能驾驶芯片负责处理驾驶任务；车路协同则需要边缘端智能芯片在路侧实现实时收集、低延时传输道路与车辆、车辆之间的交互信息；传感器采集的许多数据将会回传至云端，进而使用云端或边缘端智能芯片处理复杂的训练、推理任务。如果上述芯片未采用统一的基础系统软件平台，体系不兼容，云边端之间存在开发壁垒，客户将需要耗费大量的时间、金钱和人力成本进行繁琐的移植，而且无法发挥车载智能驾驶芯片的最优性能。因此，只有基于统一的软件生态，才能充分调动“云边端车”之间的联动，通过软件一键升级，实现全方位芯片性能升级。 公司一直在评估该应用领域的业务及产品策略。寒武纪作为人工智能芯片的龙头企业，是极少数有能力、有潜力构建“云边端车”统一智能生态的厂商，不会缺席这样一个重要的人工智能应用场景。
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 5 月 31 日